



105 化學錫 Electroless Solder

§產品說明

105 化學錫專用於電路板、電子零件，可在銅或銅合金上沉積純錫，因特殊自催化反應，使厚度可突破傳統的 1.0 微米，且速度快，藥液穩定，並可連續補充操作。

§槽液配置

105 化學錫

100%

§操作條件

溫度	40°C (35-50)
時間	10-30min
攪拌	機械擺動 (不可使用空氣攪拌)
加熱器	石英或鐵氟龍

§維護與控制

- 1、槽次法：每公升建浴新液處理 1 平方米，整槽更新。
- 2、依錫含量補充：錫濃度 105 建浴液添加量：
 - ① 每提高 5g/L，加 105 化學錫 125ml/L。
 - ② 須先排去同補充量之液，再行補加。
- 3、建議用化學錫製程後加上恆利肯公司的後處理劑一起使用。